

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

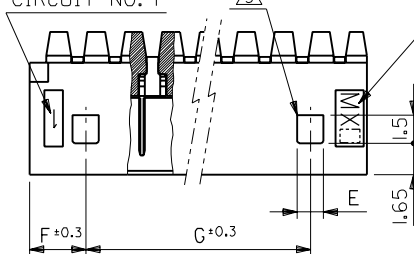
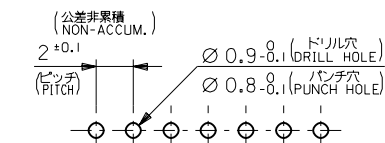
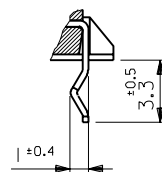
5

4

3

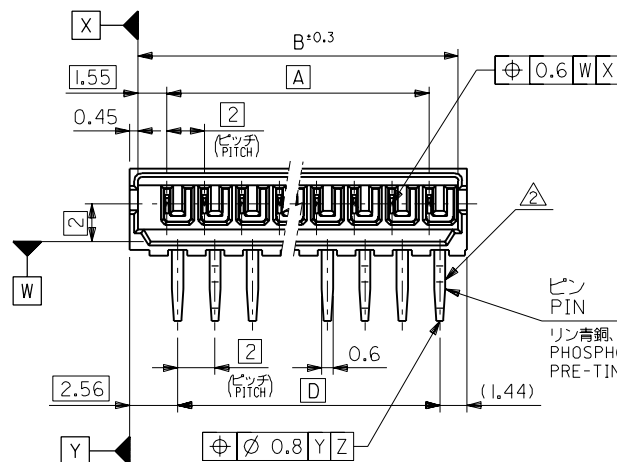
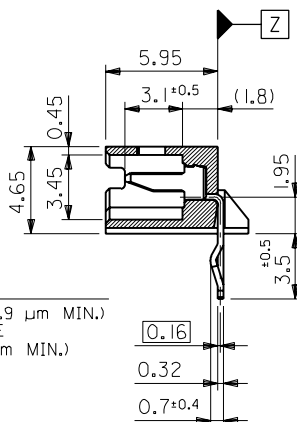
2

1

回路番号 1
CIRCUIT NO. 1トレードマーク
TRADE MARK2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD
BE ADDED ON BOTH TAILS.基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM. (REF.)
(t=1.6)

注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51004 シリーズ
MATES WITH : 51004 SERIES
2. 3極以上のキンクは、1極おきに2カ所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER
SOLDER TAILS.(FROM THE TRADE MARK SIDE)
3. ロック穴は、2極と3極は1カ所、4極以上は2カ所とする。
LOCKING HOLE : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKTS.
TWO PLACES FOR 4 AND MORE THAN 4 CKTS.

ピン
PINリン青銅、錫メッキ (0.9 μm MIN.)
PHOSPHOR BRONZE
PRE-TINNED(0.9 μm MIN.)ウェハー
WAFERガラス繊維入りナイロン66 (カラー: オフホワイト)
GLASS FILLED NYLON66 (COLOR: OFF-WHITE)
UL94V-0

角度	ANGLE	±3°
30以上 OVER		±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER		±0.25
10未満 UNDER		±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

再作図及び変更 REDRAWN & REVISED (J30279)	H.H.	'93/3/31
変更内容 REVISION RECORD	M.F.	
記号 LTR	DR.	日付 DATE
	CHK.	

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DWG.
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
被覆外径 INS. RANGE	—H—
DRAWN BY '93/3/31 H.HIRAMOTO	CHK'D BY '93/3/31 H.HIRAMOTO
APP'D BY '93/3/31 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 4 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y R/A	
DWG. NO. SD-53015-**-10	REV E

8

7

6

5

4

3

2

1

53015-03